公司代码:603936 公司简称:博敏电子

博敏电子股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年度利润分配预案为:拟以截止2022年度实施权益分派股权登记日总股本638,023,104股扣除回购专户上已回购股份数量7,625,100股后的总股本为基数,每10股派现金0.2元(含税),预计派发现金股利12,607,960.08元(含税),在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,剩余未分配利润结转至下一年度。以上预案尚需提交公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博敏电子	603936	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓丹	陈思
办公地址	广东省梅州市东升工业园B区	广东省梅州市东升工业园B区
电话	0753-2328896	0753-2328896
电子信箱	zcl_huang@bominelec.com	s_chen@bominelec.com

2 报告期公司主要业务简介

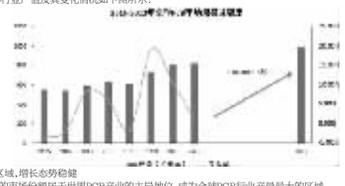
1.PCB行业发展

(1)全球PCB市场规模稳步扩容,2027年产值近千亿美元

PCB作为现代电子产品中不可或缺的电子元器件,广泛应用于消费电子、通信电子、计算机、汽车电子、工控医疗、航空航天等领域。伴随5G时代下物联网、AI、智能穿戴等新型应用场景的不断涌现,PCB行业正迎来新一轮发展周期。

受益于下游行业不断向多元化拓展以及下游需求扩张的拉动,全球PCB市场规模稳步增长。根据Prismark报告指出,受全球金融环境收紧、俄乌冲突、美国出口管制、能源市场动荡、美元升值带来的汇率变化等问题的影响,2022年全球PCB市场产值达到817.40亿美元,同比上升1%。中长期来看未来全球PCB行业仍将呈现增长趋势,Prismark预测2027年全球PCB市场规模有望达到983.89亿美元,2022-2027年全球PCB产值复合增长率约为3.8%,中国PCB产值复合增长率约为3.3%,略低于全球,预计到2027年中国PCB产值将达到约511.33亿美元。

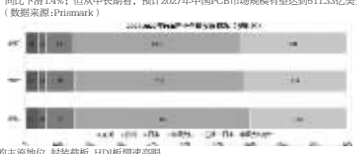
2015年至2022年,全球PCB行业产值及其变化情况如下图所示:



(2)中国依旧为产量最大区域,增长态势稳健

目前,中国大陆以超过50%的市场份额居于世界PCB产业的主导地位,成为全球PCB行业产量最大的区域。

从区域表现而言,全球各区域PCB产业未来均呈现持续增长态势,受制于2022年国内整体经济增长乏力、需求不振的影响,2022年中国大陆地区PCB产值预计为435.53亿美元,同比下滑1.4%;但从中长期看,预计2027年中国PCB市场规模有望达到511.33亿美元,2022-2027年复合增长率为3.3%,将保持稳健的增长态势。(数据来源:Prismark)



(3)多层板占据PCB产品的主流地位,封装载板、HDI板增速亮眼

根据Prismark2022Q4统计,在2022年全球PCB产品类别中,多层板占比高达37%,占比持续保持领先,随着消费电子更迭、汽车电子兴起、5G物联网落地,PCB产品逐步向轻薄化、高密度、高频高速等方向发展,封装载板、柔性板、HDI占比逐步上升,2022年这三类产品占比分别为21%、17%和14%,不断挤占多层板和单/双面板的份额。从产品结构而言,IC封装载板、HDI板仍将呈现优于行业增速的表现。据Prismark预测,2022-2027年封装载板、HDI板、18层及以上的高多层板、8-16层的高多层板仍将保持相对较高的增速,未来五年复合增速分别为5.1%、4.4%、4.4%、3.9%。

全球产品结构表现	2022年		2027年	2022年-2027年复合增长率区
	产值区(百万美元)	同比	产值区(百万美元)	
低层板/单面板/双面板	8,875	-7.4%	9,813	2.0%
4-6层板	17,836	-4.6%	20,634	3.0%
8-16层板	10,288	-3.6%	12,468	3.9%
18层板及以上的高多层板	1,722	1.8%	2,133	4.4%
HDI板	11,763	-0.4%	14,581	4.4%
封装载板	17,415	20.9%	22,286	5.1%
柔性板	13,842	-1.5%	16,473	3.5%
合计	81,740	1.0%	98,388	3.8%

未来无线通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是PCB行业长期的重要增长驱动力。为适应不同领域的需求,PCB正向着高速、高频、集成化、小型化和轻薄化的方向发展,高多层、高频高速、HDI等中高端PCB产品将保持强劲增长趋势。

2.陶瓷基板行业发展情况

(1)陶瓷基板在未来享百亿美元市场规模,AMB工艺增速亮眼

目前,电子封装技术正向小型化、高密度、多功率和高可靠性的方向发展,常用的基板材料主要有塑料基板、金属基板、陶瓷基板和复合基板四大类。陶瓷基板凭借其优异的热性能、微波性能、力学性能以及可靠性高等优点,在高频开关电源、半导体、IGBT、LD、LED、CPV、VCSEL封装中的应用起到重要作用,包含高端陶瓷基板的电子元器件模组被广泛应用于移动通信、计算机、家用电器及汽车电子等终端领域。

近年来,随着大功率半导体元器件LED、IGBT等的迭速发展,陶瓷基板需求随之增加。根据日商环球讯息有限公司(GII)《陶瓷基板:全球市场的展望(2021年-2028年)》报告,2021年全球陶瓷基板的市场规模为70.2亿美元,预计2028年达到120.3亿美元,期间年均复合增长率为8.0%。

全球市场规模(亿美金,%)				应用领域
	2020	2026E	CAGR	
DBC	2.9	4.0	8.6	IGBT功率器件、汽车领域、聚光光伏(CPV)、航空航天
AMB	4.0	16.0	25.0	IGBT功率器件、汽车领域、家用电器、航空航天
DPC	12.0	17.0	5.2	LED产品、激光器LD、VCSEL
HTCC	5.1	8.9	7.0	高频无线通信、航空航天、存储器、驱动器、滤波器、传感器、汽车电子
LTCC	65.0	127.0	10.1	手机、蓝牙、GPS模块、WLAN模块、WIFI模块、汽车电子

资料来源:GII,艾邦半导体网

(2)陶瓷基板全球供给竞争激烈,高端化下国产替代有望提速

全球陶瓷基板市场竞争激烈,据GII调研数据显示,2019年村田和京瓷的市场份额分列一二,登收合计占据全球总额的约33.15%。日本是全球最大的陶瓷基板生产市场,其陶瓷基板市场以村田、京瓷和丸和等核心厂商为主导。而欧洲则是全球第二大的生产市场,核心厂商是罗杰斯,在全球市场中位居第三。我国正成为世界电子元件的生产大国和出口大国。随着国际电子信息产品制造业加速向中国转移,下游产业的手机采购和运输成本的考虑,势必会加大本地化采购比例。

随着近年来大功率半导体元器件LED、IGBT等的迅速发展和使用,高端陶瓷线路板发展前景广阔。由于其具备特殊技术要求,加上设备投资大、制造工艺复杂,目前全球核心制造技术主要掌控于罗杰斯、韩国KCC、申和、博世等少数几家知名企业手里。国内现有技术尚无法实现高端陶瓷基板的大规模产业化生产,但面对当前人工智能、IGBT功率器件、汽车领域、聚光光伏(CPV)、通信、航天航空及其他领域市场迫切增长的需求,无论是国家政府还是国产企业,均希望能实现重大技术突破,改变陶瓷基板长期依赖进口的局面。

(3)AMB引领大功率IGBT及第三代半导体模块封装新趋势

AMB工艺生产的陶瓷衬板主要运用在电动车半导体模块上作为硅基、碳化基功率芯片的基底,目前国内的IGBT模块大部分还是采用DBC工艺。但随着工作电压、性能要求的不断提升,AMB工艺技术的陶瓷衬板能更好地解决上述痛点。相比之下,AMB技术实现了氮化铝和氮化硅陶瓷与铜片的接触,相比DBC衬板有更优的热导率、铜层结合力、可靠性等,可大幅提高陶瓷衬板的使用寿命,更适合大功率电气电路的应用场景,逐步成为中高端IGBT模块散热电路板的主要应用类型,在汽车、航天、轨道交通、工业电网领域等广泛应用。

此外,由于AMB氮化硅基板有较高热导率(≥90W/mk),可将非常薄的铜金属(厚度可达0.8mm)焊接到相对薄的氮化硅陶瓷上,载流能力较高,且氮化硅陶瓷基板的热膨胀系数与第三代半导体衬底SiC晶体接近,使其能够与SiC晶体材料匹配更稳定,因此成为SiC半导体导热基板材料首选,特别在800V以上高端新能源汽车中应用中不可或缺。

(4)新能源需求助推IGBT迎向新高度,800V高压平台为SiC带来新机遇

IGBT被广泛应用在工业控制、新能源汽车、光伏风电、变频白电、智能电网以及轨道交通等领域。据东吴证券预测,随着下游领域的快速发展,2025年中国IGBT市场空间将达到601亿元,CAGR高达30%。其中,增速最快的细分市场是新能源汽车IGBT,预计2025年我国新能源汽车的IGBT需求将达到387亿元,CAGR高达69%。

同时,碳化硅800V高压平台为碳化硅带来全新发展机遇。目前纯电动乘用车的用户痛点为充电速度较慢,进一步提高电压可以提高纯电动乘用车补能速度。当前,众多主机厂正加速布局800V高压平台,预计2023-2024年将迎来800V高压平台的快速发展期。整车上到高压平台后最重要的部件升级为电驱,而在功率模块中使用碳化硅器件是电驱升级的核心,因此,受新能源汽车应用需求的带动,碳化硅器件市场将高速增长,据Yole预测,全球碳化硅器件市场将从2021年6.10亿美元的规模增长至2027年的60亿美元以上,复合增速将高达34%;其中汽车碳化硅器件的市场将从2021年的6.05亿美元增长至2027年的近50亿美元,复合增速高达40%。

3.公司产品细分领域情况及行业地位

公司深耕PCB行业29年,布局多元化产品结构的同时,聚焦HDI板、高多层板和封装载板等高端产品以加速量产,公司2011年已实现HDI板量产,掌握任意阶产品的生产工艺技术,并通过募投项目进一步提升HDI板的出货占比。公司基于自身PCB生产工艺优势,自2018年开始筹备IC载板项目人才和技术,目前已具备量产能力,进一步拓展公司PCB产品宽度和产能规模。公司在第二十一届(2021)中国电子电路行业内资PCB企业排名12位;综合PCB企业排名25位。根据Prismark 2021年全球PCB百强企业排名显示,公司位列第43名,此外,公司还是中国电子电路行业百强企业、第五届“中国电子电路行业优秀企业”、“国家知识产权示范企业”,是中国电子电路行业协会(CPCA)副理事长单位,深圳市电路板行业协会(SPCA)副会长单位和梅州市印制电路行业协会(MPCA)名誉会长单位。

同时,公司作为国内稀有的已实现量产的陶瓷衬板生产商,目前国内AMB陶瓷基板产能相对较小,产品主要依赖进口。据艾邦陶瓷展不完全统计,国内AMB陶瓷基板企业有10家,公司AMB生产能规模在上述企业中排名第二。基于航空航天、轨道交通领域长期的客户和制造经验,掌握了薄膜和DPC陶瓷衬板制作能力,进而扩展功率器件中AMB陶瓷衬板业务。公司目前已利用自有资金投资建设,预计2023年Q4开工建设,2024年二季度或下旬产,项目达产后预计实现产值30万张/月。

(2)封装载板

IC载板,也叫封装基板,属于行业比较前沿的技术,是IC封装中用于连接芯片与PCB母板的重要材料,已在中高端封装领域取代了传统的引线框。封装载板在结构及功能上与PCB类似,由HDI板发展而来,但封装载板的技术门槛要远高于HDI和普通PCB,在线宽/线距等多种技术参数上都具备更高要求。由于具有高密度、高精度、高封数、高性能、小型化及薄型化等特点,号称PCB皇冠上的明珠。

公司2009年开始涉足HDI,具备成熟和先进的HDI生产工艺技术。子公司江苏博敏率先布局“技术同源”的封装载板业务,生产的封装载板产品覆盖种类多样,包括模组类封装载板、存储类封装载板等,应用领域主要包括智能终端、芯片/存储等,实现PCB向又一高端技术的延伸。

(3)全供应链增值服务

公司依托PCB、陶瓷衬板等优势产品,向客户提供电子装联、功能测试、模块/产品组装、EMS/ODM等全供应链增值服务,形成了优质、高效、稳定且具备成本优势的供应链体系,并及领域从家电延伸至军工、新能源(汽车、电单车、储能)、功率半导体等,能够满足细分领域龙头客户对产品品质及成本管控的要求,实现多方共赢。

未来,集成化、高压化是新能源汽车的重要发展趋势,多合一电驱动系统及高电压平台正加速渗透。大功率模组电子装联业务依托PCB事业群的专利产品——强弱电一体化特种陶瓷板衍生而来,有效解决了高度集成问题,同时提高续航里程,是集设计、生产、装联、调试的一站式服务业务,旨在成为新能源汽车功率控制模块的电子配套方案解决商。该业务的设计团队成立超过5年,拥有数百例设计案例的经验,设计能力越盖商用车、乘用车的电控PACK、BDU、PDU、OBC、VCU等,公司配备专业化的生产管理队伍和车规级的电子装联车间,可满足客户高质量、快速响应的服务需求。此外,强弱电一体化PCB助力三电系统的高集成和模块化,提高生产效率,从而降低生产成本。目前该业务已经与多家造车新势力客户对接,合作中。

高性能无源器件是基于陶瓷基板进行薄膜沉积技术制造的,目前已相继开发了隔离器、环形器、功分器、电阻器、电桥、螺旋电感等八大货架产品,产品性能在国内外均达到较高水平,助力国产化替代。

(二)公司主要经营模式

1.生产模式

公司实行以销定产的生产模式。集团产策中心负责把所接收的订单进行初步评审,结合各厂产能及产品定位分配订单,各厂计划部按照产策分配的订单,结合客户交期进行排产,产线按照计划要求严格执行,完成生产任务。

公司已建立一套高集成度的ERP信息化系统,涵盖了生产制造、工程管理、品质管理、库存管理、成本管理、商业智能等十大模块。通过该系统,计划部可对生产排期和物料管理等进行统筹安排,协调营销、供应链、制造等相关部门,保障生产有序进行,为客户提供满意的产品和服务。产线各工序设置了电子看板,可以随时了解排产和生产执行情况,进行机台极动率管理等。当产能无法满足订单需求时,相关人员可以快速识别出瓶颈工序,及时将部分瓶颈的生产环节(如钻孔、压合等)外包给其他有资质的企业完成。公司已设立专业的团队对外协商进行管理,确保外协品质和交期满足客户需求。

另外,公司每年根据战略要求,梳理瓶颈工序,实施技改升级,促使流量流速最大化,及时评估生产的必要性,不断提升瓶颈资源产能,提高产品市场占有率。同时,公司高度重视系统建设,紧随生产技术变革趋势,提高生产自动化和智能化水平,运用现代信息化管理手段进行科学管理,为公司的高速发展提供强有力的保障。

2.采购模式

集团设有供应链管理总部,负责对集团及下属子公司的采购活动和供应商管理,主要职能包括:对主材、设备、工程类采购下工作进行集团化管理,推动集团数字化及体系建设进程。搜集行业供讯,审核供应商的相关资质及报价合理性,同时协助各子公司进行成本管控,监督各子公司采购及物控日常工作的有效执行。

总部设立物料、设备工程类集采组,负责执行集团采购策略、整合资源,推动降本工作。通过对内建立ERP、OA等系统平台,对外建立供应商门户网,实现数字化、信息化供应商管理及采购流程管理的目的。各子公司均设有独立的采购部,负责本子公司各材料比价的初步洽谈,完成订单履约、异常跟进,执行集团采购策略等工作。

公司制定了《采购控制程序》《供应商管理程序》《供应商评估认证作业指导》《采购合同管理作业规范》等文件以严格控制公司对供应商的管理及对采购作业规范化,针对不同特性的原材料,公司采取不同方式进行采购:针对大宗材料,占据较高材料的采购,与供应商的合作方式为寄售,以达到不占用公司库存及流动资金的目的;针对难以管控耗用量材料的采购,与供应商合作方式为包线、包尺、包电量,以降低采购成本。

3.销售模式

公司始终秉持“以客户为中心,为客户创造价值”的理念,在公司核心发展领域积极开拓国内外行业标杆客户,与客户构建共赢、共发展的良好合作关系。

按照公司战略发展规划,产品和应用领域聚焦在电源/储能、数据通讯、汽车电子和智能终端等领域的优质客户:根据产业客户需求和公司产品特色,采用分区域和分层门槛后的组织架构模式,建立以区域营销和产品线销售相结合的销售模式。公司PCB事业群设立营销中心,作为公司对接客户的统一窗口,并按照供-产-销的高效对接机制来安排客户订单生产需求。

公司不断开拓国内外优质客户,不仅在国内传南、华东市场建立销售团队来满足客户需求,并且设立分支机构拓展海外市场。

公司与终端品牌客户或ODM、ODM客户签订“产品框架协议”或“质量保证协议”等,约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单,并约定产品规格、销售价格、数量和交期等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	6,918,501,818.02	6,561,683,119.37	5.60	5,563,756,228.81
归属于上市公司股东的净资产	3,482,270,819.53	3,615,560,573.30	-3.69	3,501,642,419.95
营业收入	2,912,387,717.13	3,520,660,297.12	-17.28	2,785,506,052.16
归属于上市公司股东的净利润	78,584,644.08	241,871,903.43	-67.51	246,713,503.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,334,499.85	211,199,999.34	-76.17	217,271,122.08
经营活动产生的现金流量净额	203,466,324.52	272,949,728.81	-25.46	71,101,428.66
加权平均净资产收益率(%)	2.15	6.83	减少4.68个百分点	9.36
基本每股收益(元/股)	0.15	0.48	-68.75	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.47	-68.09	0.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	660,894,177.00	873,564,491.07	691,187,962.30	686,741,086.67
归属于上市公司股东的净利润	40,586,196.25	68,877,109.27	20,496,462.16	-51,375,123.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,632,130.77	66,193,482.67	15,944,427.37	-63,435,540.96
经营活动产生的现金流量净额	-43,185,942.53	107,763,410.43	90,503,064.70	48,385,792.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

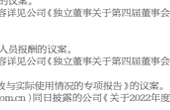
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						29,387
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						36,271
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
徐缙	0	70,661,419	13.83	0	质押 / 35,330,000	境内自然人
谢小梅	-6,710,000	39,035,389	7.64	0	质押 / 10,500,000	境内自然人
刘燕平	-1,070,000	22,613,660	4.43	0	无 / 0	境内自然人
刘长羽	2,750,300	17,716,900	3.47	0	无 / 0	境内自然人
谢建中	-4,580,000	17,002,860	3.33	0	无 / 0	境内自然人
中信证券股份有限公司	3,987,074	10,155,282	1.99	0	无 / 0	国有法人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	9,261,300	9,261,300	1.81	0	无 / 0	其他
周信义	7,250,000	7,250,000	1.42	0	无 / 0	境内自然人
李敏钰	3,129,100	3,996,600	0.78	0	无 / 0	境内自然人
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	3,958,160	3,958,160	0.77	0	无 / 0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,徐缙与谢小梅系夫妻关系;谢建中与谢小梅系兄妹关系;谢建中与刘燕平系夫妻关系;其中徐缙与谢小梅为控股股东和实际控制人,公司股东徐缙、谢小梅、刘燕平、谢建中之间存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

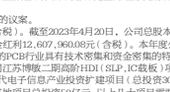
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入291,238.77万元,比上年同期下降17.28%;利润总额9,234.32万元,比上年同期下降66.50%;归属于上市公司股东的净利润7,858.46万元,比上年同期下降67.51%,其中扣除非经常性损益的净利润为5,033.45万元,比上年同期下降76.17%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2023-022

博敏电子股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2023年4月10日以电子邮件方式发出通知,于2023年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《公司监事会议事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2022年年度报告》及摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2022年度内部控制评价报告》。

三、审议通过关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在2022年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过关于公司《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过关于公司《2022年度财务决算报告》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

八、审议通过关于公司2023年度对外担保额度预计的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:临2023-024)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、审议通过关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案。

公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:临2023-025)及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过关于制定公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过关于续聘2023年度会计师事务所的议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

十二、审议通过关于确认2022年度公司高级管理人员报酬的议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过关于公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2023-026)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过关于公司2022年度内部控制评价报告的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过关于召开公司2022年年度股东大会的议案。

经董事会审议,同意于2023年5月12日召开公司2022年年度股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:临2023-029)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2023-023

博敏电子股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2023年4月10日以电子邮件方式发出通知,于2023年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《公司监事会议事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2022年年度报告》及摘要》。

监事会认为:公司2022年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》等相关法律法规及《公司章程》的规定;

(2)公司《2022年年度报告及摘要》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司《2022年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任;

(4)公司在《2022年年度报告及摘要》的编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2022年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司内部控制体系基本规范,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,不存在财务报告或非财务报告内部控制的重大缺陷。公司《2022年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司报告期的内部控制情况,其决策程序合法合规。监事会对《2022年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过关于公司《2022年度财务决算报告》的议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过关于公司2023年度对外担保额度预计的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:临2023-024)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:临2023-025)及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,公司遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,能在一定程度上降低汇率对公司的影响,规避和防范汇率大幅波动所带来的潜在风险,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为181,643.71万元(均系公司为子公司以及子公司之间提供的担保),不存在为其他第三方提供担保的情形),占公司最近一期经审计净资产的49.33%;公司对控股子公司提供的担保总额为181,643.71万元,占公司最近一期经审计净资产的49.33%(不含本次预计的担保额度)。目前公司及子公司对外担保的在保余额为79,720.79万元(不含本次担保)。

备注:担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2023年4月22日

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2023-025

博敏电子股份有限公司
关于2023年度开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●交易目的:为规避和防范汇率波动对公司正常业务开展造成影响,博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司计划开展外汇套期保值业务,以降低汇率波动对公司经营业绩带来的潜在风险。

●交易品种:外汇币种主要为美元、欧元及港元等。

●交易工具:远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。

●交易场所:合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构。

●交易金额:公司及子公司拟预计使用总额不超过4,500万美元或其他等值币种的自有资金开展外汇套期保值业务,自董事会审议通过之日起12个月内有效,并可在上述额度内循环滚动使用。

●已履行的审议程序:公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际需要,拟与银行等金融机构开展累计不超过4,500万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务,该议案无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务交易情况概述

(一)交易目的

公司及子公司部分业务需采用外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,不仅会影响公司业务的正常进行,而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为提高外汇资金使用效率,有效规避外汇市场的风险,降低汇率波动对公司经营的影响,合理降低公司财务费用,公司及子公司拟在商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

(二)交易金额

2023年度,公司及子公司拟预计使用总额不超过4,500万美元或其他等值币种的开展外汇套期保值业务,可在上述额度内循环滚动使用,任一时点的交易金额不超过授权的额度(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)。

(三)资金来源

资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

在合规并满足公司外汇套期保值业务条件的商业银行等金融机构进行交易,交易品种主要为外汇币种,如美元、欧元及港币等。交易工具包括远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。

本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2023年1月修订)》的规定。

(五)交易期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司根据实际需要,与银行等金融机构开展累计不超过4,500万美元或其他等值外币的外汇套期保